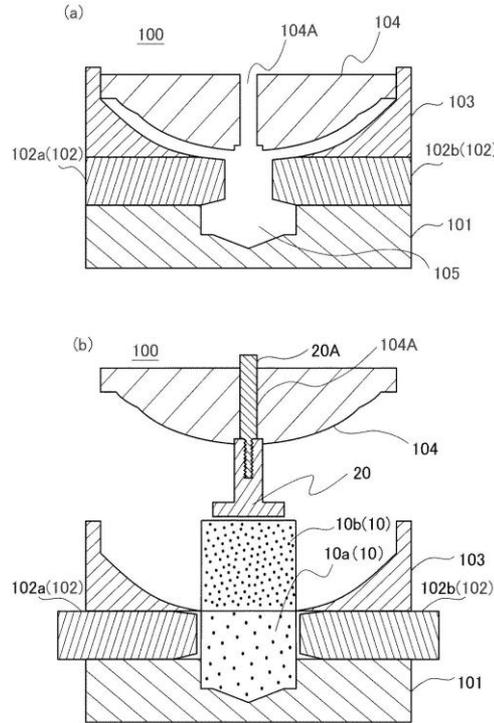


発明の名称	フッ素樹脂成形体の成形方法、医療用ダイヤフラムの製造方法、及び半導体用ダイヤフラムの製造方法		
出願人/権利人	JASI株式会社	発明者	樋口 淳一
出願日	平成31年4月1日	出願番号	2019-537852
公開番号	—	特許番号	6634574
法的状態	登録中		

代表図



- 10 積層体
- 10a 第一層
- 10b 第二層
- 20 金型部材
- 20A 治具
- 100 一次金型
- 101 金型
- 102 金型
- 102a 金型
- 102b 金型
- 103 金型
- 104 上側金型
- 104A 貫通孔
- 105 キャビティ

発明の概要

部位毎に特性が異なるフッ素樹脂成形体を一体成形物として成形する成形方法

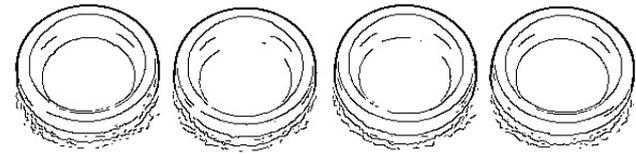
特徴

フッ素樹脂の粉体を一次金型で押圧することにより予備成形体を成形し、予備成形体を焼成後に二次金型に充填して押圧した状態で冷却することにより、フッ素樹脂成形体を成形するフッ素樹脂成形体の成形方法である。さらに、フッ素樹脂成形体の成形方法を利用した血清又はワクチンの製造に用いる医療用ダイヤフラムの製造方法、並びに半導体製品の洗浄に用いる半導体用ダイヤフラムの製造方法である。特に、医療用又は半導体用のダイヤフラムの製造に最適である。さらに、工業用、農業用、研究用、食品用等、他の用途のダイヤフラムを製造する場合においても利用可能である。

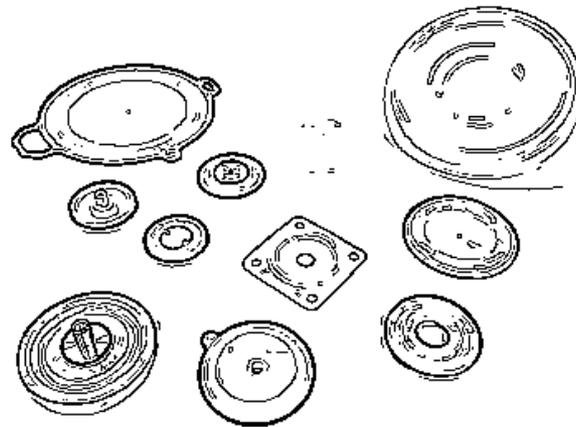
応用の可能性



医療用ダイヤフラム



半導体用ダイヤフラム



汎用ダイヤラフラム

応用の可能性

- ・医療用ダイヤフラム
- ・半導体用ダイヤフラム
- ・汎用ダイヤラフラム
- など

本技術の活用が見込める企業の一例

- ・株式会社興伸工業
- ・株式会社エイチツー
- ・株式会社イワキ
- ・株式会社タクミナ
- ・株式会社TAIYO
- ・株式会社ヤマダコーポレーション
- ・日機装株式会社
- ・日本ピラー工業株式会社
- ・富士テクノ工業株式会社
- ・共立機巧株式会社
- ・入江株式会社
- ・東横化学株式会社
- ・株式会社日阪製作所
- ・タップフロー株式会社
- ・株式会社セムコーポレーション
- など

JASI株式会社の本発明に関する最新動向

- ・JASI株式会社のホームページ(<http://www.jasi-izumi.com/index.html>)には、本件特許に関連する情報は見受けられない。